



科研产出

- 论文 >
- 专利 >
- 专著 >

当前位置 > 首页 > 科研工作 > 科研产出 > 专利

专利名称:	衬底结构、半导体器件及其制造方法
专利类别:	国际专利
申请号:	PCT/CN2011/071224
申请日期:	2011-03-04
专利号:	GB2488869
第一发明人:	钟汇才;梁擎擎
实施情况:	授权
专利证书号:	GB2488869
其它备注:	十室

